

苏州盛科通信股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《苏州盛科通信股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

如无特别说明，相关用语具有与《苏州盛科通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、公司的主营业务

公司为国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过二十余年的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列。公司在国内具备先发优势和市场引领地位，产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。

公司面向国家高性能网络的建设需求，以打造更快、更可靠、更安全、更智能的网络为目标。基于规模化市场应用的反馈、对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与，公司芯片产品完成数次迭代，现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等多项核心技术，构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。

公司现已与国内主流交换机和服务器设备厂商建立了长期深度合作，产品应

用于多家头部互联网企业的数据中心，在国内主要运营商网络和金融、政府、交通、能源等重点行业领域实现规模稳定的现网应用，充分验证了公司的产品性能与生态适配能力。

二、本次募集资金投向方案

（一）募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 480,506.90 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	下一代高性能交换芯片研发和产业化项目	330,968.11	318,064.06
2	下一代互联软件、硬件和协议研究项目	82,442.84	82,442.84
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		493,410.95	480,506.90

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（二）本次募集资金投资项目的可行性分析

1、下一代高性能交换芯片研发和产业化项目

（1）项目基本情况

本项目面向算力集群建设的蓬勃需求，公司拟开展面向高性能网络的交换芯

片创新突破，研发并产业化面向 Scale-up 和 Scale-out 的下一代高性能交换芯片系列产品。通过本次募投项目的实施，公司将进一步增强国产高性能网络的规模、性能和可靠性，满足不断演进的超节点、内存池化、存储分离等新需求，引领和促进国产互联生态的发展，提升公司在高性能交换芯片领域的长期竞争力。

（2）项目实施的必要性

1）项目实施补齐国内高性能网络交换芯片核心短板

交换芯片是算力集群数据互联的核心枢纽，其直接决定算力集群的整体运行效率与产业链供应安全。当前我国算力基础设施建设正处于规模落地与效能提升的关键阶段，但算力集群互联层面仍存在短板。高性能交换芯片的供应高度集中于国际巨头，不仅带来核心元器件的供应链风险，更导致国产互联生态无法实质性落地。

本次募投项目产品可大幅提升算力有效利用率、降低大规模集群通信损耗，补齐国产算力生态链核心元器件短板，完善全国一体化算力网络核心元器件供给，打破国际巨头软硬件绑定垄断，筑牢国产算力基础设施安全底座。

2）项目实施是匹配下一代互联需求升级的必要举措

互联性能持续升级对交换芯片的需求由复杂特性集向更低时延、更高可靠性、更低单位功耗、更强运维等新需求发展。交换芯片厂商若不能保持前沿研发投入、快速跟进下一代产品迭代，将无法匹配算力网络快速升级的技术和产品需求。

本次募投项目产品可支撑超节点内低延迟互联、大规模集群无阻塞转发的需求，通过本次募投项目的研发和产业化落地，公司将全面匹配下游客户新一代高性能网络建设需求，稳固并深化现有客户合作关系，提升公司的长期竞争力。

3）项目实施是公司持续发展、提升竞争优势的必要选择

公司作为国内首批且少数具备以太网交换芯片规模量产能力的厂商，有必要紧跟高性能网络行业持续进发的技术和市场需求，加快面向高性能网络的高性能交换芯片研发，从而构建可全面适配不同规模算力集群的全场景产品体系，进一步巩固公司在国产交换芯片领域的龙头地位，打开大规模算力集群高端市场的长

期成长空间，持续提升公司在高性能网络交换芯片领域的核心竞争力。

（3）项目实施的可行性

1) 国家持续出台算力网络建设支持政策，为本项目提供坚实政策保障

本次募集资金投向深度契合国家算力网络建设与关键核心技术攻关的顶层战略导向，多项国家和产业政策为项目实施提供了明确指引与全方位支撑，为高性能交换行业发展创造了良好的政策环境。

从国家顶层战略来看，2026 年 3 月发布的“十五五”规划纲要明确指出“加快国家枢纽算力设施集群建设”以及全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。高性能交换芯片是算力集群数据互联的核心枢纽，是算力网络高效调度的关键基础器件，是“十五五”时期集成电路攻坚的重要细分方向。

从产业部署来看，2026 年 5 月国家数据局发布的《2026 年数字经济发展工作要点》提出“筑牢数字基础设施底座，加快建设全国一体化算力网，推动数据、网络、算力、能源等资源协同布局”；2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》，明确提出“有序推动先进计算、服务器、通信设备等重点领域重大项目布局”、“强化服务器、芯片和关键模块的兼容适配”，为高性能交换芯片的技术研发与生态适配提供了明确的产业政策支持。

综上，国家层面战略牵引与产业端政策支持为公司在高性能交换领域的技术攻关、产品落地与市场推广创造了良好的政策环境与发展机遇，本项目具备坚实的政策可行性和实施保障。

2) 公司拥有国内领先的交换芯片研发团队，具备十余次规模量产落地经验，为本项目的顺利推进提供了坚实可靠的技术支持

公司为国内首批且少数拥有以太网交换芯片设计和规模量产能力的企业，核心研发团队具备二十年以上交换芯片全流程研发经验，在高性能交换架构、高性能端口设计、Scale-up/Scale-out 等关键领域形成了完整的自主知识产权体系，深

度理解超节点、大规模算力集群等复杂场景需求，具备从产品定义、架构设计到流片量产的交换芯片全栈设计能力，自成立以来已规模量产十余款成熟商用交换芯片。其中，公司面向大规模数据中心和云服务需求、交换容量达到 12.8Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片已在客户处进入应用阶段。因此，公司的研发实力及产品性能、稳定性经过严苛的下游市场验证，获得交换芯片产业生态的高度认可。截至 2026 年 6 月末，公司已累计获得知识产权 818 项，其中发明专利 620 项。

公司高度重视人才培养和储备，截至 2026 年 6 月末，公司拥有研发人员 412 人，占总人数 74.50%。公司研发团队结构梯队完善、人员稳定，配套完善的薪酬激励机制，有效保障团队长效稳定发展，充足的高端人才储备为项目顺利落地、持续创新迭代提供了可靠的人力支撑。

3) 优质客户资源与稳定的生态合作为项目顺利实施提供有利条件

公司是国内领先的以太网交换芯片设计企业，在以太网交换芯片领域持续保持国内厂商领先地位，已构建成熟稳定的产业生态合作体系。公司与国内主流交换机和服务器设备厂商建立了长期深度合作，充分验证了公司的产品性能与生态适配能力。

由于交换芯片具有平台型、长生命周期特点，一旦芯片供应商进入下游客户供应链体系后，基于产品兼容性、运维稳定性与迭代延续性考量，双方通常会形成长期稳固的合作关系，因此优质、稳定的客户储备是高端芯片项目实现产业化落地的核心前提。本次募投项目目标客户与应用场景与公司现有客户和应用场景高度重合，公司可依托已建立的客户合作基础与生态适配能力，快速推进产品适配、样品测试与导入认证，有效缩短新产品市场推广周期，保障项目建成后快速实现订单转化与产能消化，为本次募投项目的技术落地、产品适配与市场推广奠定了扎实的客户基础与场景验证条件。

2、下一代互联软件、硬件和协议研究项目

(1) 项目基本情况

本项目面向大模型技术持续迭代与算力产业规模化落地的核心需求，依托公司在高性能网络领域的生态积累与高性能交换芯片技术底座，开展面向高性能网

络的下一代体系研究攻关。公司重点布局三大研发方向：1）软件方面：研发高性能网络协议栈、智能运维与高可靠管理软件，解决大规模算力集群部署运维痛点；2）硬件方面：顺应高性能网络密度与性能持续提升的技术趋势，开展光电融合下一代互联技术研究；3）协议方面：适配超节点、资源池化、异构计算等新兴算力体系需求，研发下一代开放互联协议，支撑国内自主高性能网络生态持续发展。

（2）项目实施的必要性

1）高性能网络软件的可靠性和易用性是互联技术规模应用的核心基础

高性能网络硬件的性能高度依赖于全栈软件的适配与支撑，软件层的成熟度直接决定算力集群的实际算力利用率与技术落地推广速度。算力集群的网络运维复杂度随集群规模提升呈指数级上升。随着国产硬件进入规模落地期，打造高可靠、易运维的高性能网络软件栈是降低算力集群部署运维成本、充分释放硬件性能、加速国产互联方案规模商用的必要前提。

2）光电融合为高性能网络的核心演进方向

全球光电集成现已进入商用落地关键期，国际龙头已凭借先进封装、硅光工艺与产业生态优势形成先发领跑态势。若国内厂商仍沿传统纯电互联路线演进，将持续处于技术跟随状态，难以实现对国际一流水平的追赶乃至超越，国内产业链加快光电融合核心技术攻关具备现实的紧迫性。

布局光电融合高性能交换芯片，兼具战略安全价值与经济价值。战略层面，突破光电融合核心技术，可补齐我国高性能网络领域的核心技术短板；经济层面，光电融合可大幅降低单比特传输能耗，减少机房的供电与散热支出，有效降低算力运营成本，契合算力产业商业化降本增效的核心诉求。

当前国际龙头技术迭代持续加快，而光电融合领域研发周期长、资本与人才投入门槛高，国内产业追赶的窗口期正在收窄。公司作为国内领先的以太网交换芯片厂商，亟需加大研发投入，协同产业链上下游开展攻关，加快光电融合交换芯片核心技术突破，抢占下一代高性能互联技术体系的先发地位。

3）研发开放互联协议，筑牢国产算力生态底层支撑

互联协议是超节点弹性扩展、异构算力协同的核心技术底座，直接决定算力集群的通信效率与协同能力。传统互联协议多针对单一算力类型设计，难以支撑异构资源的统一调度，不同硬件的协议壁垒大幅抬升了跨体系协同成本；另一方面，传统协议在大规模部署场景下，路由开销、全局同步成本与拥塞影响随节点数量呈指数级上升，形成制约算力扩容的规模性能瓶颈。公司作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，开展下一代互联协议的技术探索与攻关，完善前沿技术布局。

（3）项目实施的可行性

1) 公司具备坚实的互联软件技术基础，深度贡献开放协议软件生态

公司在交换芯片软件栈领域拥有二十余年的全栈技术积累，已形成覆盖芯片驱动、开放驱动层、运维管理工具的完整软件产品体系，产品已在运营商、数据中心、金融、能源等多行业场景实现十余年的规模商用，可靠性、稳定性经过严苛的长周期现网验证。

公司已提前布局算力专用拥塞控制算法、无损网络协议、全链路可视化运维等核心技术，可有效降低通信开销、提升集群算力利用率。公司是开放高性能网络软件的核心贡献单位，在 SAI 和 SONiC 社区均提交大量贡献，实现广泛产品应用，为本项目高性能网络软件的研发与落地提供了成熟的技术底座与生态支撑。

2) 公司具备光电融合技术先发积累，牵引国内产业生态协同攻关

公司作为国内交换芯片领域的龙头企业，提前布局下一代光电融合技术，已组建跨领域光电融合研发团队，具备高速接口设计、光电协同仿真、封装测试调试等全流程技术，在高速光信号调制、光电融合低功耗技术等核心技术领域形成了自主知识产权积累，为后续 CPO（共封装光学）技术的研发与产业化打下了坚实的技术基础。

当前，公司已与国内光芯片、光模块以及先进封装测试厂商达成光电融合技术攻关的一致共识，公司作为国内领先的以太网交换芯片厂商，牵头开展产业链研发，打通从芯片设计、封装制造到系统应用的全链路技术路径。公司当前已协

同产业链合作伙伴完成多个 NPO（近封装光学）原型的开发与功能验证。公司在交换芯片领域的优势地位与技术积累，可有效牵引光电融合产业链上下游协同创新，保障本项目光电融合技术研发成果后续快速落地。

3) 公司在高性能网络协议领域具备深厚的技术积累和成熟的产业链合作基础

面向高性能网络新需求，公司将投入核心研发团队攻关超节点互联、异构资源统一寻址、大规模集群全局同步等核心技术，目标形成自主可控的高速互联核心。同时公司深度参与国内算力开放互联标准的制定工作，为本项目下一代互联协议的研发、标准制定与生态推广提供了可靠的技术与产业支撑。

3、补充流动资金

(1) 项目基本情况

公司本次募集资金拟使用 80,000.00 万元用于补充流动资金，有助于解决公司经营发展过程中对流动资金的需求，保障公司可持续发展。

(2) 项目实施的必要性

芯片设计行业属于资金、技术、人才密集型行业，无论是芯片研发、流片、IP 购置还是人才引进等环节均需持续投入大量资金。此外，随着工艺制程迭代升级，研发、流片等费用将随之大幅提升，配置的研发团队规模亦需持续扩张。芯片设计上游晶圆制造和封装测试均存在一定周期性，为保证稳定的下游交付能力，公司需要维持合理充足的备货规模。因此，维持长期高额的研发投入和资金储备是保持公司竞争优势的必要前提。

补充流动资金不仅有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，也有利于公司优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低，有利于优化公司的资本结构、降低流动性风险、提高公司抗风险能力。公司本次发行的部分募集资金用于补充公司流动资金，有助于充实公司日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。

（3）项目实施的可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

集成电路作为国家战略性、基础性产业，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合实力的重要标志之一。公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，面向国家高性能网络的建设需求，以打造更快、更可靠、更安全、更智能的网络为目标。公司所在集成电路设计行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，公司主营业务属于科技创新领域。

本次募投项目紧密围绕公司主营业务，包括“下一代高性能交换芯片研发和产业化项目”、“下一代互联软件、硬件和协议研究项目”以及“补充流动资金”。通过本次募投项目的实施，在高性能交换芯片产品方面，公司可匹配大模型高速迭代和训推业务升级的发展趋势，补齐国内高性能网络的核心短板、完善算力基础设施；在核心技术方面，公司可构建软硬协同、光电融合、开放兼容的下一代高性能互联技术体系，为公司后续产品迭代储备核心技术。从而，公司可进一步抢占近年来持续高速增长的高性能交换芯片市场，牵引国产高性能网络生态，引领高性能网络的创新和演进。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借

予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

（二）本次募投项目促进公司科技创新水平提升

集成电路设计行业尤其是交换芯片行业属于技术密集型和资金密集型行业，具有投资周期长、研发难度高、研发投入大等特点，因此保持高强度研发投入和高水平的研发能力是公司保持核心竞争力的关键。通过本次募投项目的实施，公司将进一步把握目前国内高性能网络行业的发展机遇，巩固在国内以太网交换芯片领域的竞争优势和竞争壁垒，进一步提升高性能交换领域的核心技术水平，提升公司市场地位和综合竞争力。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026年9月2日